公司代码:688233　　公司简称:神工股份

锦州神工半导体股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。公司总股本170,305,736股,扣除回购专用账户950,416股,可参与利润分配股数169,355,320股,合计拟派发现金红利12,701,649元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.87%,2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	神工股份	688233	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常亮	宋梦施
联系地址	辽宁省锦州市太和区中信路46号甲	辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
电话	+86-416-7119889	+86-416-7119889
传真	+86-416-7119889	+86-416-7119889
电子信箱	info@thinkon-cn.com	info@thinkon-cn.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,公司抓住下游市场需求回暖的契机,严控成本、加强管理,不仅扩大了大直径硅材料产品的收入规模,还提高了毛利水平。硅零部件业务,公司的研发投入符合市场需求,市场推广取得显著进展,营业收入大幅增加,在国产半导体供应链中占据了有利位置。在下游客户面临技术出口管制导致的供应链风险时,公司发挥了独特的支撑作用,并伴随下游客户的国产化突破,进一步打开了市场空间。主要销售纪分别如下:

1、大直径硅材料

这一业务板块的产品,按直径覆盖了从14英寸至22英寸所有规格,主要销售给中国、日本、韩国的下游客户,因此也可称之为“集成电路刻蚀用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力,在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平,也是公司的主要营业收入来源。

报告期内,公司大直径硅材料产品生产情况稳定,产能逐步提升中;产品结构继续优化升级,利润率较高的16英寸以上产品收入占比进一步提升,从2023年度的39.01%提升至2024年度的51.61%,毛利率为69.19%,对该业务的整体毛利率水平修复和提高有较大贡献。

2、硅零部件

上述“大直径硅材料”,经过切片、磨片、腐蚀、打微孔、形状加工、抛光、清洗等一系列精密加工后,最终做成等离子刻蚀机用硅零部件。公司是具备“从晶体生长到硅零部件成品”完整制造能力的一体化厂商,拥有全球领先的大直径硅材料晶体制造技术,是等离子刻蚀机设备厂家所需硅零部件产品的上游材料供应商。硅零部件产品具有“品种多、批量小”的特点,具体产品消耗最依集成电路制造厂商的等离子刻蚀机种类、腔体结构、数量和具体制造工艺所决定,尺寸越大,设计要求越复杂的产品,对加工能力要求越高,毛利率相对越高。

根据公司目主调研数据,国内硅零部件市场已有26亿元人民币/年以上的市场规模,以向海外厂商进口为主。随着全球半导体制造产业链向中国转移的趋势,以及中国本土等离子刻蚀设备厂商技术水平起超全球一流,中国市场未来成长性可期。

报告期内,硅零部件产品实现收入11,849.41万元,同比增长214.82%。目前公司硅零部件产品整体销售数量不断攀升,其中加工难度较大、价值较高的产品销售占比逐步扩大。公司配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品,适用于12英寸等离子刻蚀机,能够满足等离子刻蚀设备原厂不断提升的技术升级要求。公司产品的应用,已经从研发机型扩展至成熟量产机型。

为保证未来客户批量订单的及时交付,公司子公司已经在泉州、锦州两地扩大生产规模,实现了较快速度的产能爬升。

3、半导体大尺寸抛片

公司以生产技术门槛高、市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片为目标,致力于满足该产品的国内需求。轻掺低缺陷硅片主要用于低电压高性能电子产品,如手机等;而重掺硅片则较多用于高电压产品,如充电器、家用电器、交通设备、通信设备等。低压产品的设计线宽更细小,对硅片内在缺陷的控制要求更高,目硅片表面一般不做或只做很薄的外延层。轻掺低缺陷抛光硅片可以应用于8英寸相对高端的产品制程,拥有较高的附加价值。从全球市场8英寸硅片总需求上看,轻掺硅片占全部需求的70%-80%;在12英寸硅片总需求中,轻掺硅片占比几近100%。公司现阶段轻掺低缺陷硅片产品对标日本信越化学公司生产的同类硅片。该获硅片目前市场价格相对较高,因销售地区、付款条件、客户策略等差异略有不同。

报告期内,半导体大尺寸硅片实现收入702.14万元。公司持续提升生产管理水平,通过优化排产计划及厉行节俭措施,在满足国内主流集成电路制造厂商验证需求的条件下,兼顾了经济效益,为未来更大规模供货打下良好基础。

2.2主要经营模式

公司主营业务为大直径硅材料、硅零部件、半导体大尺寸硅片及其应用产品的研发、生产和销售,其采购、生产、销售模式如下:

1、采购模式

公司产品生产用原材料,包装材料根据“以产定购”的原则进行采购工作安排。

公司建立了供应商管理体系和供应商认证制度,根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等情况对供应商进行综合评估,将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后,公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况,定期从产品质量和供货情况等方面对供应商进行持续评估和认证,根据评估结果调整采购订单的分配,并确保主要原材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

2、生产模式

公司采取“客户订单+自主备货”的生产模式。公司根据客户发送的定制化产品订单情况组织采购和生产。此外,公司还会结合下游市场需求预测和与客户沟通情况统筹安排备货计划。

公司建立了《产品标识和可追溯管理规定》,每一件产成品均可以通过产品编号检索至单晶工艺跟踪单,从而获得产品的具体生产日期、质量检验员、生产班组等信息。产品质量的可追溯性为公司持续改进管理水平和生产工艺提供了重要保障。公司已经通过ISO9001:2015标准质量管理体系认证和IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证。

3、销售模式

公司主要采用大客户直销的模式进行销售,营销部负责公司现有客户的维护和潜在客户的开发。客户发送订单至公司,经公司确认订单条款,双方对产品类型、数量、价格以及交货期等要素达成一致后按照订单约定履行各自义务。公司根据订单约定交付产品后,将持续跟踪客户产品到货情况及销售回款情况。

公司下游客户对大直径硅材料及其应用产品有较高质量要求,对供应商选择有较为严格的筛选、考核体系。公司成功进入下游客户供应链体系一般需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试验、批量生产、售后服务评价等环节,认证过程严格、认证周期较长,一般为3-12个月不等。为了保证高品质产品的稳定供应,一旦通过下游客户的认证,客户会与供应商建立长期稳定的合作关系。

公司在拓展潜在客户时,会对客户进行背景调查,在对客户的技术要求进行内部评估的同时,对客户报价进行成本效益核算,进而对是否进入该潜在客户供应链体系进行综合判断。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

经过半个多世纪的发展,“全球分工、自由贸易、效率优先”的国际半导体产业链已经发展成熟,分工严密且不断加深;但另一方面,近年国际政治经济局势的变化,也正在推动全世界主要经济体走向“芯片制造本土化”,各国竞相推出巨额补贴和政策支持,上马本土集成电路制造产能,全球集成电路制造产能出现“结构性扩张”的趋势。

SEMI于2025年1月宣布,2024年全球半导体产能增长6.6%。SEMI另外预测,从2025年至2027年,全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的4,000亿美元,其中2025年相对2024年的同比增长预计达到24%,首次突破1,000亿美元,达到1,232亿美元。集成电路制造厂作为产业链核心企业,短期内大规模增加的资本开支,将对上游设备和材料厂商提供发展机遇。

公司处于行业上游的半导体硅材料行业,深深根植于全球半导体产业链,同时伴随中国本土产业链发展而壮大。半导体硅片市场的出货量及单价,影响并带动其它硅材料产品,是硅材料市场最敏感气度的晴雨表。SEMI于2025年2月公布数据,2024年全球半导体硅片出货量为12,66亿平方英寸,同比下滑2.7%;总销售额达115亿美元,同比下滑6.5%,下降的原因是部分细分领域的终端需求放缓,影响了芯片制造厂的利用率及特定应用的硅片出货量。SEMI认为,蓬勃发展的生成式人工智能和新的数据中心建设驱动了HBM等高端芯片产品出货,但大多数其他终端市场仍在从过剩库存中复苏。

目前,全行业仍处于产能扩张阶段,海外领先硅片生产工商的新增产能将陆续于2025年投入量产,中国本土产能正在稳健扩充并挤压海外厂商市场空间。全球市场份额排名第二位的日本胜高公司认为,目前全球半导体市场需求的结构性特征明显:人工智能相关需求强劲,但其余领域仍然疲软。

(2)基本特点

半导体级硅材料行业有“三高”的特点:

1)资金壁垒高

半导体级硅材料行业属于资金密集型行业,前期涉及厂房、设备等巨额资本投入,且生产所需高精度制造设备和质量检测设备的采购资金占比很高,固定资产投资规模庞大。同时规模化生产是行业参与者降低成本提升市场竞争力的必要手段,因此市场新进入者必须达到一定的经济规模,才能与现有企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争。

2)技术壁垒高

半导体级硅材料质量优劣的评价标准主要包括晶体尺寸、缺陷密度、元素含量、元素分布均匀性等一系列参数指标。实际生产过程中,除了热场设计、原材料高纯度化处理外,需要匹配各类参数并把握晶体成长窗口期以控制固液界面形状。在密闭高温腔体内进行原子有序排列并完成晶体生长是复杂的控制工程,工艺难度较高。同时规模化生产是行业参与者降低成本提升市场竞争力的必要手段,因此市场新进入者必须达到一定的经济规模,才能与现有企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争。

3)人才壁垒高

我国半导体级硅材料行业起步较晚,相比国外先进水平较为落后,具备相关理论知识和行业经验的高级技术人才以及熟练的技术工人都相对匮乏。市场新进入者难以在短时间内获得足够有丰富经验的专业性技术人才,而行业人才的培养、经验的积累以及高效的协作都需要较长时间。

3)市场壁垒高

半导体级硅材料行业下游客户为保证自身产品质量、生产规模和效率、供应链的安全性,十分注重供应商生产规模、质量控制与快速反应能力。因此,行业下游客户会对供应商执行严格的考察和全面认证程序,涉及技术评审、产品检价、样品检测、小批量试用、批量生产等多个阶段,行业下游客户确保供应商的研发能力、生产设备、工艺流程、管理水平、产品质量等即能达到认证要求后,才会考虑与其建立长期的合作关系。因此,认证周期较长,认证时间成本较高。一旦供应商进入客户供应链体系,基于保证产品质量的稳定性、控制供应商量通过拓与维护成本等多方面的考虑,客户一般不会轻易改变已定型的产品供应结构。

(3)主要技术门槛

1)大直径硅材料晶体生长技术

公司大直径硅材料产品尺寸主要为14-22英寸,主要销售给半导体等离子刻蚀设备硅零部件制造商,经一系列精密的机械加工制作成为集成电路制造刻蚀环节所需的核心硅零部件。公司生产并销售的集成电路刻蚀用大直径硅材料纯度为10到11个9,产品质量核心指标达到国际先进水平,可满足7nm及以下先进制程芯片刻蚀环节对硅材料的工艺要求。

公司凭借先进晶体生长技术、高纯度硅材料提纯技术、热场尺寸优化工艺等多项业内领先的工艺或技术,使公司能够实现不借助强磁场,仅在常规单晶生长设备上生长出大直径的单晶硅晶体,从而在维持较高良品率和参数一致性水平的基础上,有效降低了单位生产成本;

公司顺应晶体“大型化”的市场趋势,引入了新型长晶设备,改良了热系统,提升生产过程数字化水平,提高了管理精细度,优化了工艺方案,实现了效率提升;大直径多晶硅材料及其制成品生产技术方面,公司研发团队攻关多晶硅长晶制造工艺,不断提升晶体良品率,能够满足客户对更大尺寸晶体的需求。

2)硅零部件加工技术

大直径硅材料经过切片、研磨、钻孔、腐蚀、抛光、检验等多道精密加工步骤后,可制成等离子刻蚀机用的硅零部件,如:硅上电极、硅片托环等。等离子刻蚀机的气体通过气体分配盘,经由硅上电极的近千个细微小孔进入刻蚀机腔体中,在一定电压的作用下,形成高强度的等离子体,去轰击刻蚀小孔的环境表面,实现芯片图案的下蚀;同时,上电极及硅片托环与芯片同处于刻蚀机腔体中,受等离子体的刻蚀后,逐渐变薄,当这些硅零部件厚度减少到一定程度时,需要替换新的部件,以满足等离子刻蚀机所需要的工艺条件。因此,硅零部件是晶圆制造刻蚀工艺的核心耗材。硅零部件的物理特性和化学特性对于晶圆表面的沟槽精度、均匀性等指标有着重大影响。

等离子刻蚀设备厂商或集成电路制造商通常对硅零部件的选择有着很高的要求,加工难度极高。以硅上电极为例,该产品有近千个微孔,每个微孔的尺寸精度、位置精度等都有极高要求,甚至每个微孔内壁表面的保持一定程度的光滑度,以达到孔内壁“不易产生异物污染”的要求;同时,刻蚀气体经过每个微孔后,孔径内壁腐蚀变化程度也需要保证一致性。在进行表面、外形加工过程时,刀具与硅材料的接触过程中,极易造成微观层面的崩裂等表面细微损伤,这种表面损伤可延伸至产品内部,造成产品在使用过程中的异常。所以,近千个微孔的加工必须一气呵成。如果中间有异常,整个上电极就会成为不良品。

公司经过长时间的研发,掌握了硅零部件的加工技术,在高深径比钻孔技术、孔内腐蚀技术、清洗技术等方面建立了坚实的基础,产品已经交付客户使用,反馈良好。

3)半导体大尺寸硅片行业技术

公司以生产技术门槛高、市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片(正片)为目标,目前从全球市场8英寸硅片总需求上看,轻掺硅片占全部需求的70%-80%左右;在12英寸硅片总需求中,轻掺硅片占比几近100%。公司已掌握了包括8英寸轻掺低缺陷硅片在内的国内主流集成电路制造厂商验证需求的条件下,兼顾了经济效益,为未来更大规模供货打下良好基础。

2.3主要经营模式

公司正密切关注行业内的研发,掌握了硅零部件的加工技术,在高深径比钻孔技术、孔内腐蚀技术、清洗技术等方面建立了坚实的基础,产品已经交付客户使用,反馈良好。

3)半导体大尺寸硅片行业技术

公司以生产技术门槛高、市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片(正片)为目标,目前从全球市场8英寸硅片总需求上看,轻掺硅片占全部需求的70%-80%左右;在12英寸硅片总需求中,轻掺硅片占比几近100%。公司已掌握了包括8英寸轻掺低缺陷硅片在内的国内主流集成电路制造厂商验证需求的条件下,兼顾了经济效益,为未来更大规模供货打下良好基础。

(2)主要经营模式

公司正密切关注行业内的研发,掌握了硅零部件的加工技术,在高深径比钻孔技术、孔内腐蚀技术、清洗技术等方面建立了坚实的基础,产品已经交付客户使用,反馈良好。

(3)行业竞争格局、市场地位、主要技术水平或生产经营模式的重大变化情况

(1)、行业竞争格局:

公司产品生产用原材料、包装材料根据“以产定购”的原则进行采购工作安排。

公司建立了供应商管理体系和供应商认证制度,根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等情况对供应商进行综合评估,将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后,公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况,定期从产品质量和供货情况等方面对供应商进行持续评估和认证,根据评估结果调整采购订单的分配,并确保主要原材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

(2)、市场地位:

公司以生产技术门槛高、市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片为目标,致力于满足该产品的国内需求。轻掺低缺陷硅片主要用于低电压高性能电子产品,如手机等;而重掺硅片则较多用于高电压产品,如充电器、家用电器、交通设备、通信设备等。低压产品的设计线宽更细小,对硅片内在缺陷的控制要求更高,目硅片表面一般不做或只做很薄的外延层。轻掺低缺陷抛光硅片可以应用于8英寸相对高端的产品制程,拥有较高的附加价值。从全球市场8英寸硅片总需求上看,轻掺硅片占全部需求的70%-80%;在12英寸硅片总需求中,轻掺硅片占比几近100%。公司现阶段轻掺低缺陷硅片产品对标日本信越化学公司生产的同类硅片。该获硅片目前市场价格相对较高,因销售地区、付款条件、客户策略等差异略有不同。

报告期内,半导体大尺寸硅片实现收入702.14万元。公司持续提升生产管理水平,通过优化排产计划及厉行节俭措施,在满足国内主流集成电路制造厂商验证需求的条件下,兼顾了经济效益,为未来更大规模供货打下良好基础。

(3). 技术创新研发、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)半导体市场技术特性变化对产品定制研发和本土市场开发能力提出更高要求

报告期内,全球半导体市场呈现结构性变化,SEMI认为,2024年全球半导体市场的增长来自前沿的逻辑芯片和代工、生成式人工智能、高性能计算等应用领域以及芯片在终端领域的需求。

一方面,生成式人工智能应用快速迭代发展,算力相关存储、逻辑芯片热销,但其对市场整体带动仍有限;另一方面,尽管AI+PC、AI+手机的初代产品已经面世并引起广泛关注,但消费电子市场能够依代智能手机的下一代主机产品尚不明确。因此,下游市场的不确定性增加了上游企业对趋势的判断难度,同时也对企业的产品定制研发能力提出更高要求,唯有紧跟市场变化并推陈出新的企业才能快速反应、赢得先机。

台积电于2025年1月公布的营运绩效报告显示,“高性能计算”和“智能手机”两大技术平台公司2024年总收入的比重为53%和35%,高性能计算占据年度收入来源的一半以上,且占比同比继续提升。从全年增长来看,高性能计算和智能手机平台同比增长为19%和17%,物联网和消费电子同比下滑15%和6%,这显示高端算力芯片产品需求仍然强劲,高端消费者市场需求有所回升。三星电子于2025年2月表示,2024年营业收入同比增长6%,营业利润同比增长395%,存储芯片业务成为公司主要增长引擎,未来将加大产品升级和产能调整力度。SK Hynix在最近一期财报中下历史新高,营业利润也超过了上一轮存储市场繁荣期的业绩,该公司预测随着大型科技公司对AI服务器的投资扩大,人工智能推理技术的重要性日益增加,由此高性能计算所必需的HBM和高容量服务器DRAM的需求将持续增长。

从中国本土市场来看,2024年我国集成电路出口1,595亿美元,一举超过手机的1,344亿美元,成为出口额最高的单一商品,同比增长17%,创历史新高。中芯国际于2025年2月表示,客户产品库存相对健康,认为2025年除了人工智能继续高速成长外,市场各应用领域需求将持平或温和增长。2024年下半年,中国本土存储类集成电路制造厂商的技术进步较快,对韩国、日本的成熟存储产品如DRAM和闪存晶片造成冲击,迫使后者降价减产。这显示中国本土集成电路制造能力和规模都在稳步提升,未来有望赶超国际先进水平,将对材料和零部件厂商的定制研发能力和本土市场开发能力提出更高要求。

(2)芯片制程日趋缩小对刻蚀工艺和大直径硅材料制造技术提出更高要求

国际先进集成电路制造厂商的芯片工艺在持续进步:三星电子新投最高3nm产线良率,计划于2025年实现2nm产线量产;台积电2nm制程芯片目标定于2025年量产,2026年下半年计划量产A16制程;英特尔计划于2025年下半年量产18A工艺,14A工艺提前至2026年投产,并提出2027年实现10A制程。半导体加工制程不断进步,12英寸集成电路产品的设计线宽越来越窄,因此内槽也相应变窄,需要更高的刻蚀精度。更高的刻蚀精度,对硅片表面的温度、刻蚀气体浓度、材料性质提出更高的均匀性要求。采用更大的腔体和更大的上电极、下电极,更容易确保硅片面内各项工艺对均匀性的要求。因此,目前国际领先刻蚀机厂商的最新机型,都在向着大型化方向发展。随着以上技术工艺发展,更大尺寸的硅零部件及其所需的上游材料——更大直径的大直径硅材料16英寸以上的需求也将随之增加。

此外,以HBM为代表的人工智能所需算力芯片研发竞争日趋激烈,SK Hynix、三星、美光都计划在2025年推出各自的新一代HBM产品。三维堆叠结构的HBM产品对TSV工艺提出更高要求,刻蚀工艺的精准控制和优化对于确保TSV的准确形成和可靠性至关重要,对刻蚀技术和刻蚀应用数据提出更高要求。

目前,公司16英寸以上大直径硅材料产品的技术和产能在全球市场拥有竞争优势;公司将持续研发针对体积较大、设计难度较高的12英寸高端制程所需硅零部件产品。

(3)全球主要经济体芯片产业竞争所带来的风险与机遇并存

报告期内,美国对华技术出口管制措施继续升级。2024年12月2日,美国商务部工业与安全局(BIS)将136家中国实体和43家海外关联企业列入“实体清单”。涵盖众多中国半导体设备制造厂商、EDA软件开发商、光刻胶开发商等;2025年1月13日,美国商务部发布人工智能扩散出口管制框架临时最终规则,再次升级对华先进芯片出口管制,进一步扩大了管控范围。

此外,美国、欧盟、韩国、日本都已在实施数十亿至数百亿美元不等的半导体投资补贴政策。宏大的发展目标及巨额的公共资金支持,正在改变全球半导体产业的资源流向和投资节奏。2024年,台积电计划国近利桑那州的第一家晶圆厂开始量产4nm半导体;2024年12月,台积电位于日本熊本的工厂正式量产12至28纳米制程半导体,熊本第二工厂开始建设;2025年3月,台积电宣布将对美国再投资至少1,000亿美元,用于兴建3座晶圆厂、2座先进封装厂等设施。芯片制造产能对本土供应链的要求极高,开非化改变和补贴能够一蹴而就,公司所在的东亚、中国、日本、韩国三国的产业链优势难以撼动。

全球主要经济体面向芯片制造领域的产业政策竞争持续加剧,带来的风险与机遇并存:一方面,公司的中国本土客户向美国及其盟国进口先进设备的难度大大增加,产品研发和产能扩张受到延缓和阻碍;另一方面,随着对华技术出口管制政策收紧,下游本土客户对国产供应商的评估认证程度和性能要求日益提高,唯有紧跟市场变化并推陈出新的企业才能在竞争中脱颖而出。

(4)公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,992,903,336.46	1,932,422,436.15	3.08	1,760,698,594.62
归属于上市公司股东的净资产	1,792,961,484.97	1,761,794,579.03	1.77	1,573,266,430.97
营业收入	302,729,514.81	135,033,162.23	124.19	539,236,500.68
归属于上市公司股东的净利润	41,150,745.84	-69,109,826.01	不适用	158,141,628.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,343,442.86	-71,566,263.79	不适用	156,541,778.43
经营活动产生的现金流量净额	172,929,764.60	82,209,545.12	110.35	130,146,507.24
加权平均净资产收益率(%)	2.32	-4.31	增加6.63个百分点	10.84
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.43	不适用	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.43	不适用	0.99
研发投入占营业收入的比例(%)	8.26	16.64	减少8.38个百分点	7.30

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	58,320,271.69	66,899,606.07	88,889,623.82	88,620,014.23
归属于上市公司股东的净利润	1,461,563.89	3,300,536.21	22,723,860.58	13,664,785.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,818.12	2,898,090.92	22,128,388.02	12,321,145.80
经营活动产生的现金流量净额	34,222,489.38	44,146,497.71	36,786,297.30	57,774,480.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,297
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
更多投资顾问有限公司	0	37,003,560	21.73	0	无	0	境外法人
砂糖半导体科技(上海)有限公司	0	35,160,301	20.87	0	无	0	境内非国有法人
北京君天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	0	7,641,705	4.49	0	无	0	境内非国有法人
福州福勤企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,873,733	1.69	0	无	0	境内非国有法人
62股资控股有限公司	-203,750	2,338,965	1.37	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	1,393,799	1,645,421	0.97	0	无	0	其他
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有享15号私募证券投资基金	363,589	876,104	0.51	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	843,626	843,626	0.50	0	无	0	其他
姚志刚	720,000	720,000	0.42	0	无	0	境内自然人
王进平	389,423	719,421	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	砂糖半导体科技(上海)有限公司、温州昂勤企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙)已签署一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入30,272.95万元,同比增长124.19%;归属于上市公司股东的净利润4,115.07万元,实现扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688233　证券简称:神工股份　公告编号:2024-010

锦州神工半导体股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688233　证券简称:神工股份　公告编号:2025-003

锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2025年3月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2024年年度董事会工作报告的议案》

董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司2024年年度董事会工作报告》的内容,并分别听取了《锦州神工半导体股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会认为:2024年度,公司审计委员会能够充分发挥审查、监督作用,切实履行审计委员会的责任和义务;审计委员会全体委员诚信勤勉,恪尽职守,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(四)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司2024年度审计机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对容诚在2024年度的审计工作履行监督职责,并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联独立董事冯培先生、张人寿先生、王永成先生回避表决。

(七)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,综合公司2024年年度经营及财务状况,公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司2024年财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。公司总股本170,305,736股,扣除回购专用账户950,416股,可参与利润分配股数169,355,320股,合计拟派发现金红利12,701,649元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.87%,2024年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于预期2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉》

1、说明各议案已按照的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,相关公告已于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的